

NX4P7470F-1072D型 射频二极管

产品特点:

- ☑ 方形金属陶瓷封装，便于表面贴装
- ☑ 芯片双面导热，低热阻
- ☑ 气密性封装，高可靠
- ☑ 低串联电阻，低插损
- ☑ 可承受高连续波射频功率



产品描述:

NX4P7470F-1072D 型射频二极管是将射频芯片用高温焊料焊接在高导热金属电极上，并整体封装在方形金属陶瓷管壳内。此封装满足了低热阻、低插损、高可靠的使用需求，并便于回流焊和电装工艺操作。

NX4P7470F-1072D 型射频二极管非常适合大功率的串联或分流装置使用，包含 HF 到 UHF 频段的大功率射频开关电路，电台通信等。

性能参数:

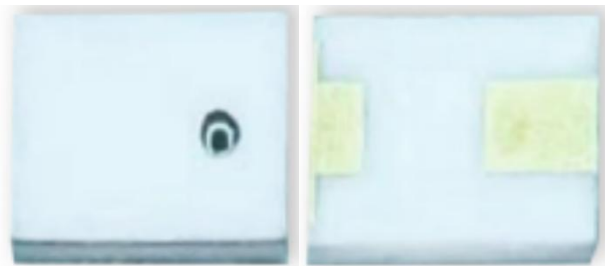
参数	测试条件	单位	最小值	典型值	最大值
正向电压	+50mA	V	—	—	1.0
反向漏电流	-1000V	uA	—	—	1
总电容	-100V @ 1MHz	pF	—	—	0.65
热阻	$I_F = 500\text{mA}$, $t_w = 1\text{mS}$	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$	—	3	5
少数载流子寿命	$I_F = +10\text{mA}$, $I_R = -6\text{mA}$	μs	—	6.5	8
I层厚度	—	μm	—	100	—
串联电阻	+100mA, 100MHz	Ω	—	0.50	0.70

注：1. 总电容=芯片结电容+寄生封装电容
2. 不建议在极限条件下持续工作

绝对最大额定参数:

参数	绝对最大值
最大反向电压	800V
热阻最大值	5℃/W
最大结温	+175℃
工作温度	-65℃ to +175℃
储存温度	-65℃ to +200℃

- 注：1. 超过这些限制中的任何一个或组合都可能对这个装置造成永久性损坏
2. 不建议在这些区域附近进行持续性操作。

外观尺寸:

	尺寸 (mm)	
	最小值	最大值
长度	2.92	3.17
宽度	1.90	2.1
高度	1.90	2.1

清洁与存储:

本产品应在清洁的环境中操作和储存。器件的金属化端部已镀锡，可焊性高，任何持续暴露在高湿度(>80%)的环境下将会导致表面氧化，长时间不用时，宜存储在氮气柜或干燥柜内。

焊接建议:

本产品耐高温，工艺操作窗口大，可采用回流焊或电烙铁进行焊接，电烙铁焊接温度不宜超过350℃，持续时间不宜超过10秒钟；回流焊温度不宜超过260℃，高温持续时间不宜超过5分钟。欲了解更多技术信息，请联系：15358194655。